

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【公開番号】特開2009-81426(P2009-81426A)

【公開日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-015

【出願番号】特願2008-219903(P2008-219903)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

G 0 6 K 19/07 (2006.01)

G 0 6 K 19/077 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

G 0 6 K 19/00 H

G 0 6 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月17日(2011.6.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に剥離層を形成し、

前記剥離層上に半導体素子層を形成し、

前記半導体素子層上に導電性樹脂を形成し、

前記半導体素子層及び前記導電性樹脂上に、第 1 の繊維体及び第 1 の有機樹脂層を含む第 1 の封止層を形成し、

前記第 1 の封止層、前記半導体素子層及び前記剥離層に溝を形成し、

前記溝に液体を滴下し、前記半導体素子層を前記剥離層から剥離し、

前記導電性樹脂上の前記第 1 の封止層を除去して開口部を形成し、

前記第 1 の封止層及び前記半導体素子層をチップに分断し、

前記開口部に導電性接着剤を形成し、

基材上に形成されたアンテナに前記チップを貼り合わせて、前記導電性接着剤を介して前記導電性樹脂と前記アンテナとを電氣的に接続し、

前記アンテナ及び前記チップを覆うように、第 2 の繊維体及び第 2 の有機樹脂層を含む第 2 の封止層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 の繊維体及び前記第 2 の繊維体は、有機化合物材料又は無機化合物材料の単系

を複数本束ねた経系及び緯系が密に織り込まれていることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記第 1 の繊維体及び前記第 2 の繊維体は、織布または不織布であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれか一において、

前記第 1 の繊維体及び前記第 2 の繊維体は、ポリビニルアルコール系繊維、ポリエステル系繊維、ポリアミド系繊維、ポリエチレン系繊維、アラミド系繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール繊維、ガラス繊維、または炭素繊維で形成されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のいずれか一において、

前記液体は、水、アルコール、炭酸水のいずれか 1 つを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれか一において、

前記導電性樹脂が形成されている領域の上部から前記第 1 の封止層にレーザービームを照射することにより、前記開口部を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。